

OPALE Miroir

Quand les E/S doivent être accessibles par l'avant

Pour certaines applications, ou des fois par habitude, le câblage des cartes d'entrées/sorties doit se faire par l'avant de la baie.

L'avantage est important lorsque l'on doit souvent déplacer le PC Industriel ou modifier le câblage. Dans d'autres cas, le type de connectique et sa courbure, trop gourmands en place, ne permettent pas une connectique standard par l'arrière de la baie. Enfin, l'accessibilité n'est pas toujours aisée derrière une machine sur site.

L'OPALE Miroir offre cette originalité d'avoir tout accessible directement sur l'avant du châssis : cartes E/S bien sûr, mais aussi connectique de la carte SBC, alimentation 1U extractible simple ou redondante, disques Serial ATA hot swappable. Même la ventilation vient de l'arrière et sort devant. Renversant, non !



	PICMG 1.0	PICMG 1.3	
Spécifications du châssis			
Châssis	Châssis en Inox 12/10ième. Oreilles de fixation 19" et poignées d'extraction		
Dimension	19 pouces, 4U, profondeur 500 mm		
Ventilation	Flux d'air arrière avant - 2 ventilateurs de 108 CFM - Filtre à poussière en face arrière		
Alimentation	Alimentation EPS12 520W - 90~264VAC auto-range Module alimentation extractible depuis la face avant – Alimentation redondante en option.		
Support de masse	2 x disques SATA extractible en face avant – 2 x 3" 1/2 interne		
Slot d'extension	10 x PCI 32bit 4 x ISA	1 x PCIe x16 / 1 x PCIe x1 1 x PCI-X @ 133MHz 4 x PCI-X @ 66MHz 2 x PCI 32bit / 2 x ISA	2 x PCIe x8 (connecteur x16) 4 x PCI-X @ 66MHz 4 x PCI @ 33MHz
Face avant	Grille slot 14 positions - Bouton PWR et Reset - LED PWR et activité disque – Tiroir disque (x2)		
Face arrière	Trappe d'accès aux ventilateurs et au filtre à poussière		
Option	Glissière télescopique 20 ou 26 pouces		
Spécifications des cartes processeurs			
Bus Passif	PICMG 1.0	PICMG 1.3 Graphic Class	PICMG 1.3 Server class
Processeur	Socket LGA 775 - Intel® Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Core 2 Duo	Intel® Core™ Duo Intel® Core™ Solo Intel® Celeron® M	Mono ou Bi Dual-Core Intel® Xeon® LV
Chipset	Intel® Q963 + ICH8	Intel® 945G + ICH7R	Intel® E7520 + E6300ESB
Mémoire	DDR2-533/667 – Dual Channel 2 Go max. – 2 x DIMM	DDR2-400/533/667 - DC 4 Go max. – 2 x DIMM	DDR2-400 ECC Reg. – DC 8 Go max. – 4 x DIMM
Graphique	Intel® Graphics Media Accelerator Q963	Intel® Graphics Media Accelerator 950	ATI® RAGE™ MOBILITY™ M1 – 8Mo
LAN	2 ports 10/100/1000BaseT	2 x 10/100/1000BaseT 1 x 10/100BaseT	2 x 10/100/1000BaseT
Disque	2 x SATA-II - 1 x ATA-100	4 x SATA-II - 1 x ATA-100 Raid 0,1,10,5 (SATA)	2 x SATA - 2 x ATA-100
USB	4 x USB 2.0	6 x USB 2.0	4 x USB 2.0
Watchdog	Programmable : 1sec ~ 255 min.	N/A	Programmable : 1 ms ~ 10 min
Spécifications environnementales			
Température	En fonctionnement : 0~50°C / En stockage -20~70°C		
Hygrométrie	10 à 90% sans condensation		
Chocs et vibrations	Chocs en fonctionnement : 10G, 11ms Vibrations en fonctionnement : 0.8G de 5~100 Hz		
Certification CE	Compatibilité électromagnétique : UE 89/336/EEC – EN 61000-6-2, EN55022, EN 55024 Sécurité : UE73/23/EEC – EN 60950:2000		